

2015-2022年中国半导体封 测市场分析与投资前景研究报告

报告目录及图表目录

博思数据研究中心编制

www.bosidata.com

报告报价

《2015-2022年中国半导体封测市场分析与投资前景研究报告》信息及时，资料详实，指导性强，具有独家，独到，独特的优势。旨在帮助客户掌握区域经济趋势，获得优质客户信息，准确、全面、迅速了解目前行业发展动向，从而提升工作效率和效果，是把握企业战略发展定位不可或缺的重要决策依据。

官方网站浏览地址：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1509/X516189MRJ.html>

【报告价格】纸介版7000元 电子版7000元 纸介+电子7200元

【出版日期】2015-09-17

【交付方式】Email电子版/特快专递

【订购电话】全国统一客服务热线：400-700-3630(免长话费) 010-57272732/57190630

博思数据研究中心

特别说明：本PDF目录为计算机程序生成，格式美观性可能有欠缺；实际报告排版规则、美观。

说明、目录、图表目录

报告说明:

博思数据发布的《2015-2022年中国半导体封测市场分析与投资前景研究报告》共五章。报告介绍了半导体封测行业相关概述、中国半导体封测产业运行环境、分析了中国半导体封测行业的现状、中国半导体封测行业竞争格局、对中国半导体封测行业做了重点企业经营状况分析及中国半导体封测产业发展前景与投资预测。您若想对半导体封测产业有个系统的了解或者想投资半导体封测行业，本报告是您不可或缺的重要工具。

报告目录：

第（一）章 全球半导体产业

1.1 全球半导体产业概况

1.2 IC设计产业

1.3 IC封测产业概况

1.4 中国IC市场

第（二）章 半导体产业格局

2.1 模拟半导体

2.2 MCU

2.3 DRAM内存产业

2.3.1 DRAM内存产业现状

2.3.2 DRAM内存厂家市场占有率

2.3.3 移动DRAM内存厂家市场占有率

2.4 NAND闪存

2.5 复合半导体产业

第（三）章 IC制造产业

3.1 IC制造产能

3.2 晶圆代工

3.3 MEMS代工

3.4 中国晶圆代工产业

3.5 晶圆代工市场

- 3.5.1 全球手机市场规模
- 3.5.2 手机品牌市场占有率
- 3.5.3 智能手机市场与产业
- 3.5.4 PC市场
- 3.6 IC制造与封测设备市场
- 3.7 半导体材料市场

第（四）章 封测市场与产业

- 4.1 封测市场规模
- 4.2 封测产业格局
- 4.3 WLCSP市场
- 4.4 TSV封装
- 4.5 半导体测试
 - 4.5.1 Teradyne
 - 4.5.2 Advantest
- 4.6 全球封测厂家排名

第（五）章 封测厂家研究

- 5.1 日月光
- 5.2 Amkor
- 5.3 硅品精密
- 5.4 星科金朋
- 5.5 力成
- 5.6 超丰
- 5.7 南茂科技
- 5.8 京元电子
- 5.9 Unisem
- 5.10 福懋科技
- 5.11 江苏长电科技
- 5.12 UTAC
- 5.13 菱生精密
- 5.14 南通富士通微电子

5.15 华东科技

5.16 颀邦科技

5.17 J-DEVICES

5.18 MPI

5.19 STS Semiconductor

5.20 Signetics

5.21 Hana Micron

5.22 Nepes

5.23 天水华天科技

5.24 Shinko

2011-2015年全球半导体封装材料厂家收入

2011-2015年中国IC市场规模

2015年中国IC市场产品分布

2015年中国IC市场下游应用分布

2015年中国IC市场主要厂家市场占有率

2015年模拟半导体主要厂家市场占有率

2015年Catalog 模拟半导体厂家市场占有率

2015年10大模拟半导体厂家排名

2015年MCU厂家排名

2000-2015年DRAM产业CAPEX

2000-2015年全球DRAM出货量

2013年10月-2015年1月DRAM合约价涨跌幅

2013年2季度-2015年2季度全球DRAM厂家收入

2013年2季度-2015年2季度全球DRAM晶圆出货量

2001-2015年 系统内存需求量

2015年2季度Dram品牌收入排名

2011-2015年Mobile DRAM市场份额

GaAs产业链The GaAs Based Devices Industry Chain

GaAs产业链主要厂家

2012-2015年全球GaAs厂家收入排名

2015年全球12英寸晶圆产能

1999-2015年全球12英寸晶圆厂产能地域分布

2013年4季度-2015年2季度主要Fab支出产品分布

2013年2季度-2015年2季度全球晶圆加载产能产品分布

2011-2015年全球晶圆设备开支地域分布

2011-2015年全球Foundry销售额排名

2011-2015年全球主要Foundry运营利润率

2015年全球前30家MEMS厂家收入排名

2015年全球前20大MEMS Foundry排名

2015年中国Foundry家销售额

2015年全球前25家IC设计公司排名

2011-2015年全球手机出货量

2013年2季度-2015年2季度每季度全球手机出货量 与年度增幅

2011-2015年3G/4G手机出货量地域分布

2011-2015年每季度全球主要手机品牌出货量

2011-2015年全球主要手机厂家出货量

2011-2015年全球主要手机厂家智能手机出货量

2015年智能手机操作系统市场占有率

2011-2015年全球PC用CPU与GPU 出货量

2011-2015年NETBOOK iPad 平板电脑出货量

2011-2016全球晶圆设备投入规模

2015-2022年全球半导体厂家资本支出规模

2015-2022年全球WLP封装设备开支

2015-2022年全球Die封装设备开支

2015-2022年全球自动检测设备开支

2015-2022年全球TOP 10 半导体厂家资本支出额

2011-2015年全球半导体材料市场地域分布

2011-2015年全球半导体后段设备支出地域分布

2011-2015年OSAT市场规模

2015年全球IC封装类型出货量分布

2015年全球IC封装类型出货量分布

2011 2011 2015年全球封测市场技术分布

2015年全球OSAT产值地域分布

2011-2015年台湾封测产业收入

2015-2022年WLCSP封装市场规模

2015-2022年WLCSP出货量下游应用分布

Fan-in WLCSP 2011-2016 unit CAGR by device type

手机CPU与GPU封装路线图

2013年2季度-2015年2季度 Teradyne收入与运营利润率

2013年2季度-2015年2季度Teradyne SOC产品新订单

2015年4季度 Teradyne销售额与在手订单地域分布

2011-2014财年Advantest订单部门分布与业务分布

2011-2014财年Advantest收入部门分布与业务分布

2013年2季度-2015年2季度Advantest订单部门分布

2013年2季度-2015年2季度Advantest订单地域分布

2013年2季度-2015年2季度Advantest收入部门分布

2013年2季度-2015年2季度Advantest收入地域分布

2000-2015年Advantest半导体测试部门销售额下游应用分布

Advantest全球分布

2011-2015年全球前24大封测厂家收入

日月光组织结构

2001-2015年日月光收入与毛利率

2011-2015年ASE收入业务分布

2013年2季度-2015年2季度ASE铜线绑定Copper Wirebonding 收入

2013年2季度-2015年2季度ASE铜线绑定转换率

2013年2季度-2015年2季度ASE铜线绑定Copper Wirebonding 收入地理分布

2013年2季度-2015年2季度ASE铜线绑定Copper Wirebonding 收入客户分布

2013年2季度-2015年2季度ASE封装部门收入 毛利率

2013年2季度-2015年2季度ASE封装部门收入类型分布

2013年2季度-2015年2季度ASE测试部门收入 毛利率

2013年2季度-2015年2季度ASE测试部门收入业务分布

2013年2季度-2015年2季度ASE材料部门收入 毛利率 运营利润率

2013年2季度-2015年2季度ASE CAPEX与EBITDA

2015年2季度ASE10大客户

2015年2季度ASE收入下游应用

ASE中国分布

ASE 上海封装类型

2004-2015年ASE上海收入

2011-2015年Amkor收入与毛利率 运营利润率

2011-2015年Amkor收入封装类型分布

2013年4季度-2015年2季度Amkor收入封装类型分布

2013年4季度-2015年2季度Amkor出货量封装类型分布

2011-2015年2季度Amkor CSP封装收入与出货量

2015年Amkor CSP封装收入下游应用分布

2011-2015年2季度Amkor BGA封装收入与出货量

2015年Amkor BGA封装收入下游应用分布

2011-2015年2季度Amkor Leadframe封装收入与出货量

2015年2季度Amkor Leadframe封装收入下游应用分布

2013年2季度-2015年2季度Amkor封装业务产能利用率

2003-2015年硅品收入 毛利率 运营利润率

2011-2015年2季度硅品收入地域分布

2011-2015年2季度硅品收入下游应用分布

2011-2015年2季度硅品收入业务分布

硅品2014年4季度 2015年1季度 2015年2季度产能统计

2004-2015年星科金朋收入与毛利率

2011-2015年2季度星科金朋收入封装类型分布

2011-2015年2季度星科金朋收入下游应用分布

2011-2015年星科金朋收入 地域分布

2011-2015年PTI收入与运营利润率

PTI工厂一览

PTI的TSV解决方案

2015年2季度PTI收入业务分布

2015年2季度PTI收入产品分布

2002-2015年Greatek收入 毛利率 运营利润率

2011-2015年超丰电子收入技术类型分布

2003-2015年ChipMOS收入与毛利率

2011-2015年ChipMOS收入业务分布

2011-2015年ChipMOS收入产品分布

2015年ChipMOS收入客户分布

2011-2015年ChipMOS收入地域分布

2002-2015年KYTEC收入与毛利率

2013年6月-2015年6月KYTEC月度收入

KYTEC厂房分布

KYTEC TESTING PLATFORMS

2011-2015年Unisem收入与EBITDA

台塑集团组织结构

2011-2015年FATC收入与运营利润率

2013年6月-2015年6月FATC月度收入

2011-2015年JECT收入与运营利润率

JCET路线图

2015年JCET收入地域分布

2011-2015年LINGSEN收入与运营利润率

2013年6月-2015年6月LINGSEN月度收入

2011-2015年Nantong Fujitsu Microelectronics收入与增幅

2011-2015年Nantong Fujitsu Microelectronics净利润与增幅

2011-2015年Nantong Fujitsu Microelectronics季度收入与增幅

2011-2015年Nantong Fujitsu Microelectronics季度净利润与增幅

2011-2015年Nantong Fujitsu Microelectronics季度毛利率

2011-2015年Nantong Fujitsu Microelectronics季度A S R&D

2011-2015年WALTON收入与运营利润率

2015年1月-2015年6月月度收入与增幅

2011-2015年Chipbond收入与运营利润率

2013年6月-2015年6月Chipbond月度收入与增幅

2013年4季度-2015年2季度颀邦收入产品分布

J-Devices Solution

2011-2014财年MPI收入与税前利润

MPI收入地域分布

Carsem 2013年2季度-2015年2季度收入产品分布

2011-2015年STS Semiconductor收入与运营利润率

Signetics股东结构

2011-2015年Signetics收入与运营利润率

2013年2季度-2015年2季度 Signetics产能利用率Utilization与运营利润率

2015年Signetics收入产品分布

2015年Signetics收入客户分布

2011-2015年Hana Micron收入与运营利润率

2015年Hana Micron收入客户分布

2011-2015年Nepes收入与运营利润率

2011-2015年Nepes季度收入与运营利润率Quarterly revenues and OP trend and outlook

2011-2015年Nepes季度收入部门分布Quarterly sales trends and forecasts by division

2011-2015年Nepes季度运营利润部门分布

2011-2015年天水华天收入与运营利润率

2011-2014财年Shinko收入与净利润

2015-2022财年Shinko收入业务分布

本研究报告数据主要采用国家统计局数据，海关总署，问卷调查数据，商务部采集数据等数据库。其中宏观经济数据主要来自国家统计局，部分行业统计数据主要来自 国家统计局及市场调研数据，企业数据主要来自于国统计局规模企业统计数据库及证券交易所等，价格数据主要来自于各类市场监测数据库。

详细请访问：<http://www.bosidata.com/qitadianzi1509/X516189MRJ.html>